

平成21年10月28日

平成22年3月期
第2四半期決算概要

次 <目

平成22年3月期 第2四半期決算短信	1
【定性的情報・財務諸表等】	4
1. 連結経営成績に関する定性的情報	
2. 連結財政状態に関する定性的情報	
3. 連結業績予想に関する定性的情報	
4. その他	
5. 四半期連結財務諸表(累計)	
(1) 四半期連結貸借対照表	12
(2) 四半期連結損益計算書(累計)	13
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(累計)	14
(4) セグメント情報(累計)	15
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	16
6. 四半期連結財務諸表(3か月)	
(1) 四半期連結損益計算書(3か月)	17
(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3か月)	18
(3) セグメント情報(3か月)	19
7. 繼続企業の前提に関する注記	20
<参考>平成22年3月期 第2四半期連結決算概要	21

問合せ先 N E C エレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

<報道関係> 枫／岡本 TEL (044) 435-1676(直通)
<PR関係> 覚知／林 TEL (044) 435-1664(直通)

平成22年3月期 第2四半期決算短信[米国会計基準]

平成21年10月28日

上場会社名 NECエレクトロニクス株式会社
 コード番号 6723 URL <http://www.necel.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長
 四半期報告書提出予定日 平成21年11月9日
 配当支払開始予定日 —

(氏名) 山口 純史
 (氏名) 遠藤 泰三

TEL 044-435-1664

(百万円未満四捨五入)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	220,467	△33.9	△36,392	—	△37,494	—
21年3月期第2四半期	333,588	△5.0	1,206	△34.9	△7	—
1株当たり四半期純利益			希薄化後1株当たり四半期純利益			
円 銭			円 銭			
22年3月期第2四半期	—	—	—	—	—	—
21年3月期第2四半期	—	—	—	—	—	—

(注1)四半期純利益(当社株主に帰属)※ 22年3月期第2四半期△38,090百万円 21年3月期第2四半期△1,907百万円

1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属) 22年3月期第2四半期△308円43銭 21年3月期第2四半期△15円44銭

希薄化後1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属) 22年3月期第2四半期△308円43銭 21年3月期第2四半期△15円44銭

※「四半期純利益(当社株主に帰属)」は、平成21年3月期までの「四半期純利益」と同じ内容です。

(注2)「1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属)」は the FASB Accounting Standards Codification (以下「ASC」という。)260「1株当たり利益」(以下「ASC260」という。)に基づいて算出してあります。

(注3)当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業利益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第2四半期	465,455	88,492	19.0	716.55
21年3月期	482,545	128,130	26.6	1,037.51

(注)株主資本の金額は、「米国会計基準」に基づいて表示しております。

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
21年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
22年3月期 (予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通期	460,000	△15.8	△46,500	—	△53,500	—

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

(注2) 当期純利益(当社株主に帰属)※ 通期 △55,000百万円

1株当たり当期純利益(当社株主に帰属) 通期 △445円34銭

※「当期純利益(当社株主に帰属)」は、平成21年3月期までの「当期純利益」と同じ内容です。

(注3) 詳細は、10ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う子会社の異動) 無
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)
- | | |
|-----------------|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 有 |
| ② ①以外の変更 | 無 |
- (注)詳細は、11ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
- (4) 発行済株式数(普通株式)
- | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 22年3月期第2四半期 | 123,500,000株 | 21年3月期 | 123,500,000株 |
| ② 期末自己株式数 | 22年3月期第2四半期 | 2,306株 | 21年3月期 | 2,306株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 22年3月期第2四半期 | 123,497,694株 | 21年3月期第2四半期 | 123,497,900株 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、業績見通しと乖離する可能性があります。

(百万円未満四捨五入)

(参考) 平成22年3月期第2四半期(3か月)の連結業績(平成21年7月1日~平成21年9月30日)

(1) 連結経営成績(3か月)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高	営業利益	税引前四半期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
22年3月期第2四半期	118,507 △29.2	△15,457 —	△16,720 —
21年3月期第2四半期	167,306 △5.7	△495 —	△286 —

	1株当たり 四半期純利益	希薄化後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第2四半期	—	—
21年3月期第2四半期	—	—

(注1) 四半期純利益(当社株主に帰属)※ 22年3月期第2四半期△17,400百万円 21年3月期第2四半期△590百万円

1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属) 22年3月期第2四半期△140円89銭 21年3月期第2四半期△4円78銭

希薄化後1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属) 22年3月期第2四半期△140円89銭 21年3月期第2四半期△4円78銭

※「四半期純利益(当社株主に帰属)」は、平成21年3月期までの「四半期純利益」と同じ内容です。

(注2) 1株当たり四半期純利益(当社株主に帰属)はASC260に基づいて算出しております。

(注3) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業利益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日～平成21年9月30日)の連結業績

(単位 億円)

	前第2四半期 連結累計期間 (4～9月)	当第2四半期 連結累計期間 (4～9月)	前年同期比 増(減)	
売 上 高	3,336	2,205	△1,131	△33.9%
半導体売上高	3,184	2,118	△1,065	△33.5%
営業損益	12	△364	△376	-
税引前損益	△0	△375	△375	-
四半期純損益(当社株主に帰属)	△19	△381	△362	-
米ドル為替レート(円)	105	97	-	-
ユーロ為替レート(円)	163	132	-	-

当第2四半期連結累計期間(4～9月)の連結売上高は2,205億円と、前年同期と比べ1,131億円(33.9%)の減少となりました。

製品分野別でみると、すべての分野において売上高が前年同期と比べ減少、特に、コンピュータおよび周辺機器分野においては、売上高が前年同期と比べ50%以上の減少となりました。

また、前年同期と比べ為替レートが円高であったことも、売上高が減少する要因となりました。

連結営業損益は364億円の損失で、前年同期と比べ376億円の悪化となりました。これは、生産関連費用、研究開発費および人件費の削減等により、前年同期と比べ大幅に固定費を削減したものの、連結売上高が前年同期と比べ大幅に減少したことなどによるものです。

連結税引前損益は375億円の損失で、前年同期と比べ375億円の悪化となりました。これは、連結営業損益が前年同期と比べ悪化したことが主な要因であります。

連結四半期純損益(当社株主に帰属)は381億円の損失で、前年同期と比べ362億円の悪化となりました。

以下、平成22年3月期第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)に係る説明を記載しております。平成22年3月期第1四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年3月期第1四半期決算短信(平成21年7月29日開示)をご参照ください。

(2)当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)の経済および事業環境

当第2四半期の世界経済は、各国の景気刺激策が奏功して景気の持ち直しの動きが継続した一方、先行きへの新たな懸念材料も顕在化しました。米国では住宅価格底打ちの兆しが出てきたものの失業率は大きく上昇、欧州では新車販売台数は増加したものの、ここでも雇用情勢は悪化、中国などアジア諸国では家電や自動車などの内需は増えたものの先進国向け輸出は低迷するなど、世界的に斑模様の景気動向となりました。

こうした情勢の中で、当社の事業領域である半導体業界では、各国の景気刺激策による薄型テレビや自動車などの需要増を受け、回復基調が継続いたしました。しかしながら、世界的に見ても景気の先行きが依然として不透明であることや、景気刺激策が需要を先食いしていることによる反動を懸念する向きもあることから、今後の半導体需要の動向については、依然、予断を許さない状況と見ております。

(3)当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)の連結業績

(単位 億円)

	前第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	当第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	前年同期比 増(減)	
売 上 高	1,673	1,185	△488	△29.2%
半導体売上高	1,592	1,138	△454	△28.5%
営業損益	△5	△155	△150	-
税引前損益	△3	△167	△164	-
四半期純損益(当社株主に帰属)	△6	△174	△168	-
米ドル為替レート(円)	108	95	-	-
ユーロ為替レート(円)	166	135	-	-

当第2四半期の連結売上高は1,185億円と、前年同期と比べ488億円(29.2%)の減少となりました。

製品分野別でみると、すべての分野において売上高が前年同期と比べ減少、特に、コンピュータおよび周辺機器分野においては、第1四半期に引き続き、売上高が前年同期と比べ40%以上の大幅な減少となりました。

連結営業損益は155億円の損失で、前年同期と比べ150億円の悪化となりました。これは、生産関連費用、研究開発費および人件費の削減等により、前年同期と比べ大幅に固定費を削減したものの、連結売上高が前年同期と比べ大幅に減少したことによるものです。

連結税引前損益は167億円の損失で、前年同期と比べ164億円の悪化となりました。これは、連結営業損益が前年同期と比べ悪化したことが主な要因であります。

連結四半期純損益(当社株主に帰属)は174億円の損失で、前年同期と比べ168億円の悪化となりました。

(4) 当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)の製品分野別連結売上高実績

当第2四半期の製品分野別の連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	当第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	前年同期比 増(減)	
通信機器分野	163	134	△28	△17.4%
コンピュータおよび周辺機器分野	306	168	△138	△45.1%
民生用電子機器分野	319	226	△93	△29.1%
自動車および産業機器分野	288	230	△58	△20.1%
多目的・多用途I C	231	154	△77	△33.4%
ディスクリート・光・マイクロ波	286	226	△60	△21.0%
半導体計	1,592	1,138	△454	△28.5%
その他の	81	47	△34	△41.8%
合計	1,673	1,185	△488	△29.2%

◆ 通信機器分野 売上高 134億円 (前年同期比17.4%減)

通信機器分野の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ28億円(17.4%)減少し、134億円となりました。

当分野には、ルータ、携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や携帯電話端末向け半導体が含まれます。

当第2四半期は、主にブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や、携帯電話端末向けカメラL S IやL C D(液晶ディスプレー)ドライバI Cの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

◆ コンピュータおよび周辺機器分野 売上高 168億円 (前年同期比45.1%減)

コンピュータおよび周辺機器分野の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ138億円(45.1%)減少し、168億円となりました。

当分野には、サーバおよびワークステーション向け半導体やパソコンおよびパソコン周辺機器向け半導体が含まれます。

当第2四半期は、主に液晶テレビやパソコン用モニタ向けL C DドライバI CやD V D(デジタル多用途ディスク)ドライブ向けL S Iの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

◆ 民生用電子機器分野 売上高 226億円 (前年同期比29.1%減)

民生用電子機器分野の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ93億円(29.1%)減少し、226億円となりました。

当分野には、家電製品向け半導体やゲーム機向け半導体が含まれます。

当第2四半期は、ブルーレイ・ディスク機器向けを中心に画像処理L S I「E M M A(エマ)」シリーズの売上が前年同期と比べ増加したものの、ゲーム機向け半導体や白物家電向け半導体などの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

◆ 自動車および産業機器分野 売上高 230億円 (前年同期比20.1%減)

自動車および産業機器分野の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ58億円(20.1%)減少し、230億円となりました。

当分野には、自動車向け半導体、F A(ファクトリ・オートメーション)機器などの産業機器向け半導体が含まれます。

当第2四半期は、主に自動車向けマイクロコントローラの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

◆ 多目的・多用途 I C 売上高 154億円（前年同期比33.4%減）

多目的・多用途 I C の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ77億円(33.4%)減少し、154億円となりました。

当分野には汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途のS R A Mなどが含まれます。

当第2四半期は、市場環境悪化による需要減などにより、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途S R A Mの売上が、総じて前年同期と比べ減少いたしました。

◆ ディスクリート・光・マイクロ波 売上高 226億円（前年同期比21.0%減）

ディスクリート・光・マイクロ波の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ60億円(21.0%)減少し、226億円となりました。

当分野には、ダイオード、トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信やD V D向け光半導体、携帯電話端末などに使用されるマイクロ波半導体が含まれます。

当第2四半期は、ディスクリート半導体や、光半導体・マイクロ波半導体など化合物半導体の売上が、市場環境悪化による需要減などにより前年同期と比べ減少いたしました。

◆ その他の 売上高 47億円（前年同期比41.8%減）

その他の当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ34億円(41.8%)減少し、47億円となりました。

当分野には、主に当社の販売子会社が行っているL C Dパネルの再販など、半導体以外の製品の販売事業が含まれます。

(5) 当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)の所在地別連結売上高実績

当社あるいは当社の子会社の所在地別に分類した、当第2四半期の連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	当第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	前年同期比 増(減)	
日本	853	639	△214	△25.1%
米国	117	73	△44	△37.8%
欧州	247	150	△97	△39.4%
アジア	456	323	△133	△29.1%
合計	1,673	1,185	△488	△29.2%

(注) 当社の子会社の所在地において、日本および米国以外の各区分に属する国は以下のとおりです。

欧州：ドイツ、英国、アイルランド

アジア：中国、インドネシア、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾

◆ 日本 売上高 639億円（前年同期比25.1%減）

日本では、主にゲーム機向け半導体、汎用マイクロコントローラおよびディスクリート半導体の売上が減少したことにより、当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ214億円(25.1%)減少し、639億円となりました。

◆ 米国 売上高 73億円（前年同期比37.8%減）

米国では、主に自動車向けマイクロコントローラやブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体の売上が減少したことにより、当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ44億円(37.8%)減少し、73億円となりました。

◆ 欧州 売上高 150億円（前年同期比39.4%減）

欧州では、主に自動車向けマイクロコントローラや汎用マイクロコントローラの売上が減少したことにより、当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ97億円(39.4%)減少し、150億円となりました。

なお、前第2四半期および当第2四半期の欧州における売上高に占める大部分は、ドイツに本社を置く子会社によるものであります。

◆ アジア 売上高 323億円（前年同期比29.1%減）

アジアでは、主に液晶テレビやパソコン用モニタ向けLCDドライバICやディスクリート半導体の売上が減少したことにより、当第2四半期の売上高は、前年同期と比べ133億円(29.1%)減少し、323億円となりました。

なお、前第2四半期および当第2四半期の、中国に本社を置く子会社における売上高は、それぞれ241億円、167億円であります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 総資産および株主資本

(連結財政状態)		(単位 億円)	
	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前期末比 増(減)
総 資 産	4,825	4,655	△171
株 主 資 本	1,281	885	△396
株 主 資 本 比 率 (%)	26.6	19.0	△7.6
1株当たり株主資本(円)	1,038	717	△321
有 利 子 負 債	1,169	1,437	268

当第2四半期末の総資産残高は、4,655億円で、前期末と比べ171億円の減少となりました。これは、受取手形および売掛金の残高が増加したものの、連結四半期純損失(当社株主に帰属)を計上したことなどにより株主資本が減少したことなどによるものです。

株主資本は、885億円で、前期末と比べ396億円の減少となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において連結四半期純損失(当社株主に帰属)を381億円計上したことなどによるものです。

株主資本比率は、株主資本が減少したことにより前期末と比べ7.6ポイント低下しました。

有利子負債は、借入を実行したことなどにより、前期末と比べ268億円増加し、1,437億円となりました。

(2) 当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)の連結キャッシュ・フロー

(連結キャッシュ・フローの状況)		(単位 億円)	
	前第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	当第2四半期 連結会計期間 (7～9月)	前年同期比 増(減)
営業活動によるキャッシュ・フロー	146	107	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125	△69	56
フリー・キャッシュ・フロー	21	38	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8	72	80
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△23	△10	13
現金および現金同等物純増加(減少)額	△10	100	110
現金および現金同等物期首残高	1,590	795	△795
現金および現金同等物期末残高	1,580	895	△686

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、連結四半期純損失を計上したものの、減価償却費等を139億円計上したことや、支払手形および買掛金の増加などにより、107億円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の購入による支払が93億円であったことなどにより、69億円の支出となりました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは38億円の収入となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入を実行したことや、有形固定資産のセール・アンド・リースバック取引による入金などにより72億円の収入となりました。

以上に、為替相場の変動による現金および現金同等物の減少額10億円を考慮した、現金および現金同等物純増加(減少)額は100億円の増加となり、現金および現金同等物期末残高は895億円となりました。

なお、平成22年3月期第1四半期(4～6月)に係る連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報については、平成22年3月期第1四半期決算短信(平成21年7月29日開示)をご参照ください。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年3月期通期の連結業績見通しについて、連結売上高は期初予想と比べ200億円の減少となる4,600億円、当社の主力事業である半導体売上高は同150億円の減少となる4,450億円を見込んでおります。連結営業損益は同465億円の減少となる465億円の損失、連結税引前損益は同460億円の減少となる535億円の損失、連結当期純損益(当社株主に帰属)は同460億円の減少となる550億円の損失を見込んでおります。

当社の主力事業である半導体売上高については、5ページの経済および事業環境にも記載のとおり、各国の景気刺激策による需要増を受け、自動車向けを中心とするマイクロコントローラや、ディスクリート半導体、化合物半導体などについては、期初想定を上回る堅調な状況となっているものの、特に民生用電子機器分野において期初想定に比べて一部S o C(システム・オン・チップ)製品の売上が大幅に減少する見込みとなっております。下期(平成21年10月～平成22年3月)の半導体売上高については、第2四半期連結累計期間(平成21年4月～平成21年9月)に比べ、約10%の增收を見込んでいるものの、期初想定比では約230億円の減少となる見込みです。

連結営業損益については、製造体制の再構築の加速、研究開発の一層の効率化、人件費や経費の削減などによる固定費の削減は、期初想定通り遂行しておりますが、最先端の製造ラインの稼働が第2四半期連結会計期間の後半より悪化したことなどにより、第2四半期連結累計期間の営業損益が期初想定に比べ114億円の悪化となったこと、さらに、下期において、半導体売上高が期初想定より減少することに加えて、最先端の製造ラインにおける稼働の低迷が当面続く見込みであることなどにより、営業損益が大幅に悪化する見込みです。平成22年3月期通期については、連結営業損益の黒字化を目指しておりましたが、465億円の営業損失となる見込みです。

連結税引前損益および連結当期純損益(当社株主に帰属)については、連結営業損益が期初想定より悪化することにより、それぞれ535億円、550億円の損失となる見込みです。

また、当社は、平成21年9月16日に、株式会社ルネサス テクノロジとの間で、当社と同社の事業統合に関する統合基本契約を締結いたしました。なお、本件による当社の業績に対する影響は現時点では不明であり、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。

平成22年3月期通期連結業績予想

(単位 百万円)

	売上高	半導体売上高	営業損益	税引前損益	当期純損益 (当社株主に帰属)
期初(5/11発表)予想(a)	480,000	460,000	0	△7,500	△9,000
今回(10/28発表)予想(b)	460,000	445,000	△46,500	△53,500	△55,000
増減額(b-a)	△20,000	△15,000	△46,500	△46,000	△46,000
増減率(%)	△4.2	△3.3	—	—	—

なお、通期連結業績の見通しにあたっては、為替レートは、1米ドル90円(期初前提95円より変更)、1ユーロ130円(同125円より変更)を前提としております。

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

・会計処理基準に関する事項の変更

1. 平成21年4月1日以降、ASC810「連結」（以下「ASC810」という。）を適用しております。ASC810は、親会社以外が保有する子会社における所有持分、親会社および非支配持分へ帰属する連結上の当期純利益の金額、会社の所有持分の変動、ならびに子会社が連結対象外となったときの非支配持分投資の評価に関する基準を規定しております。ASC810の適用により、従来、連結貸借対照表の負債の部と資本の部の中間に分類していた少数株主持分を、非支配持分として純資産の部に含めて計上しております。また、ASC810の適用により、連結損益計算書の表示科目を変更しております。ASC810の表示に関する規定は遡及的に適用され、連結キャッシュ・フロー計算書を含む過年度（四半期を含む）の連結財務諸表を組替再表示しております。ASC810の適用が当社グループの財政状態および経営成績に与える重要な影響はありません。

2. 平成21年6月に、米国財務会計基準審議会は、米国財務会計基準審議会基準書第168号「米国財務会計審議会会計基準体系化および一般に認められた会計原則の階層—基準書第162号の改訂」（以下「基準書第168号」という。）を発行しました。基準書第168号は、米国会計基準を体系化するものであります。当社グループにおいては、基準書第168号を当第2四半期連結会計期間より適用し、新しく体系化された番号により記載しております。基準書第168号の適用が当社グループの財政状態および経営成績に与える影響はありません。

(4) その他

平成21年9月16日付の「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」にて公表いたしました第三者割当による新株式発行（以下「本件増資」）に関し、本決算短信にて公表いたしました当社の平成22年3月期第2四半期連結累計期間の業績によれば、本件増資の総額は約1,220億円から約128億円増加する見込みです。

なお、本件増資における増額後の発行総額、発行株式総数、割当株数等につきましては、当社の第8期第2四半期報告書提出予定日である平成21年11月9日に決定の上お知らせする予定です。

5. 四半期連結財務諸表（累計）

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日)	増（減）	前第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日)
(資産の部)				
流動資産	222,177	218,089	△4,088	344,882
現金および現金同等物	101,279	89,470	△11,809	158,029
受取手形および売掛金	52,488	67,057	14,569	95,303
たな卸資産	63,220	54,463	△8,757	82,035
その他の流動資産	5,190	7,099	1,909	9,515
固定資産	260,368	247,366	△13,002	277,165
投資等	3,474	3,908	434	3,943
有形固定資産	242,079	230,393	△11,686	257,002
その他の資産	14,815	13,065	△1,750	16,220
資産合計	482,545	465,455	△17,090	622,047
(負債・純資産の部)				
流動負債	141,907	145,326	3,419	182,207
短期借入金	1,905	7,937	6,032	1,818
支払手形および買掛金	78,763	78,605	△158	111,946
その他の流動負債	61,239	58,784	△2,455	68,443
固定負債	208,387	227,838	19,451	209,779
社債および長期借入金	114,966	135,767	20,801	115,278
未払退職および年金費用	81,167	80,761	△406	73,784
その他の固定負債	12,254	11,310	△944	20,717
株主資本	128,130	88,492	△39,638	224,817
資本金	85,955	85,955	—	85,955
資本剰余金	281,081	281,081	—	281,081
利益剰余金	△197,521	△235,611	△38,090	△116,803
その他の包括損益累計額	△41,374	△42,922	△1,548	△25,406
自己株式	△11	△11	—	△10
非支配持分	4,121	3,799	△322	5,244
負債および純資産合計	482,545	465,455	△17,090	622,047
有利子負債残高	116,871	143,704	26,833	117,096
株主資本比率	26.6 %	19.0 %	△7.6 %	36.1 %
D/E レシオ	0.91倍	1.62倍	0.71倍	0.52倍

【その他の包括損益累計額内訳】

・外貨換算調整額	△6,563	△9,004	△2,441	1,449
・年金負債調整額	△34,948	△34,261	687	△27,157
・有価証券未実現損益	137	343	206	302

(注) 連結貸借対照表の表示区分については、ASC810の適用により、平成21年9月末の表示に合わせて組替え再表示しております。

(2) 四半期連結損益計算書（累計）

(第2四半期連結累計期間)

(単位 百万円)

科 目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増(減)	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	対売上 高比率
		対売上 高比率	対売上 高比率			
売 上 高	333,588	100.0 %	220,467	100.0 %	△113,121	546,470 100.0 %
売 上 原 価	233,979	70.1	174,913	79.3	△59,066	425,918 77.9
研 究 開 発 費	56,720	17.0	48,389	21.9	△8,331	110,380 20.2
販売費および一般管理費	41,683	12.5	33,557	15.3	△8,126	78,527 14.4
當 業 損 益	1,206	0.4	△36,392	△16.5	△37,598	△68,355 △12.5
當 業 外 収 益	2,126	0.6	1,923	0.9	△203	3,761 0.7
受取利息および配当金	1,023		151		△872	1,570
雜 収 益	1,103		1,772		669	2,191
當 業 外 費 用	3,339	1.0	3,025	1.4	△314	24,741 4.5
支 払 利 息	228		253		25	319
雜 損 失	3,111		2,772		△339	24,422
税 引 前 損 益	△7	△0.0	△37,494	△17.0	△37,487	△89,335 △16.3
法 人 税 等	1,920	0.6	1,292	0.6	△628	△6,115 △1.0
持分法による投資損益	145	0.0	107	0.1	△38	307 0.1
非支配持分帰属損益控除前 四半期(当期)純損益	△1,782	△0.6	△38,679	△17.5	△36,897	△82,913 △15.2
非支配持分帰属損益(控除)	125	0.0	△589	△0.2	△714	△288 △0.1
四 半 期 (当 期) 純 損 益 (当社株主に帰属)	△1,907	△0.6	△38,090	△17.3	△36,183	△82,625 △15.1

(注) ①当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

②連結損益計算書の表示区分については、ASC810の適用により、当第2四半期連結累計期間の表示に合わせて組替え再表示しております。

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（累計）

(第2四半期連結累計期間)

(単位 百万円)

項目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	前年同期比 増（減）	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
非支配持分帰属損益控除前四半期（当期）純損益	△1,782	△38,679	△36,897	△82,913
営業活動により増加したキャッシュ（純額）への調整				
減価償却費等	32,993	28,197	△4,796	67,346
受取手形および売掛金の（増加）減少額	866	△16,930	△17,796	39,117
たな卸資産の（増加）減少額	△6,392	7,886	14,278	10,911
支払手形および買掛金の増加（減少）額	△1,448	9,061	10,509	△31,166
その他の	△5,403	△3,510	1,893	△10,228
計	18,834	△13,975	△32,809	△6,933
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産売却額	395	2,605	2,210	6,271
有形固定資産購入額	△22,167	△26,011	△3,844	△53,035
その他の	△1,596	△828	768	△2,492
計	△23,368	△24,234	△866	△49,256
フリー・キャッシュ・フロー（I + II）	△4,534	△38,209	△33,675	△56,189
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
社債および借入金の増加（減少）額	△1,116	12,147	13,263	△1,587
セール・アンド・リースバック取引による入金額	—	15,992	15,992	—
その他の	△1,211	△1,498	△287	△2,708
計	△2,327	26,641	28,968	△4,295
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△582	△241	341	△3,709
現金および現金同等物純増加（減少）額	△7,443	△11,809	△4,366	△64,193
現金および現金同等物期首残高	165,472	101,279	△64,193	165,472
現金および現金同等物期末残高	158,029	89,470	△68,559	101,279

(注)連結キャッシュ・フローの表示区分については、ASCO10の適用により、当第2四半期連結累計期間の表示に合わせて組替え再表示しております。

(4) セグメント情報

(第2四半期連結累計期間)

①製品分野別売上高

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増(減)	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	構成比 (%)	
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)				
通信機器分野	32,656	9.8	28,029	12.7	△14.2	△4,627	60,199	11.0
コンピュータおよび周辺機器分野	60,551	18.2	30,235	13.7	△50.1	△30,316	87,237	16.0
民生用電子機器分野	64,027	19.2	45,400	20.6	△29.1	△18,627	119,330	21.8
自動車および産業機器分野	58,568	17.5	38,700	17.6	△33.9	△19,868	91,492	16.8
多目的・多用途IC	44,176	13.2	28,743	13.0	△34.9	△15,433	70,478	12.9
ディスクリート・光・マイクロ波	58,383	17.5	40,715	18.5	△30.3	△17,668	92,999	17.0
半導体計	318,361	95.4	211,822	96.1	△33.5	△106,539	521,735	95.5
その他	15,227	4.6	8,645	3.9	△43.2	△6,582	24,735	4.5
合計	333,588	100.0	220,467	100.0	△33.9	△113,121	546,470	100.0

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増(減)	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	構成比 (%)	
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)				
SoC プラットフォーム	127,806	38.3	82,662	37.5	△35.3	△45,144	222,536	40.7
MCU プラットフォーム	89,691	26.9	63,930	29.0	△28.7	△25,761	141,837	26.0
個別半導体	100,864	30.2	65,230	29.6	△35.3	△35,634	157,362	28.8
半導体計	318,361	95.4	211,822	96.1	△33.5	△106,539	521,735	95.5
その他	15,227	4.6	8,645	3.9	△43.2	△6,582	24,735	4.5
合計	333,588	100.0	220,467	100.0	△33.9	△113,121	546,470	100.0

(注)

SoC (システム・オン・チップ) プラットフォーム： ASIC (特定用途向け集積回路)、ASSP (特定用途向け標準品)、メモリ

MCU (マイクロコンピュータ) プラットフォーム： マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ

個別半導体： 表示ドライバ、アナログIC、ディスクリート半導体、化合物半導体

②所在地別売上高

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)			前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	構成比 (%)
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)			
日本	174,355	52.3	120,386	54.6	△31.0	301,617	55.2
米国	24,000	7.2	12,750	5.8	△46.9	38,638	7.1
欧州	47,103	14.1	29,079	13.2	△38.3	74,468	13.6
アジア	88,130	26.4	58,252	26.4	△33.9	131,747	24.1
合計	333,588	100.0	220,467	100.0	△33.9	546,470	100.0

③所在地別営業損益

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)			前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	構成比 (%)
			構成比 (%)	前年同期比 増(減) (百万円)			
日本	△4,523	—	△36,375	—	△31,852	△66,287	—
米国	△637	—	△1,779	—	△1,142	△5,326	—
欧州	1,234	—	△191	—	△1,425	△238	—
アジア	5,132	—	1,953	—	△3,179	3,496	—
合計	1,206	—	△36,392	—	△37,598	△68,355	—

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

6. 四半期連結財務諸表（3か月）

（1）四半期連結損益計算書（3か月）

（第2四半期連結会計期間）

（単位 百万円）

科 目	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	対売上 高比率	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増（減）
			対売上 高比率		
売 上 高	167,306	100.0	118,507	100.0	△48,799
売 上 原 価	115,993	69.3	90,612	76.5	△25,381
研 究 開 発 費	30,275	18.1	26,468	22.3	△3,807
販売費および一般管理費	21,533	12.9	16,884	14.2	△4,649
営 業 損 益	△495	△0.3	△15,457	△13.0	△14,962
営 業 外 収 益	1,615	1.0	709	0.6	△906
受取利息および配当金	510		54		△456
雜 収 益	1,105		655		△450
営 業 外 費 用	1,406	0.9	1,972	1.7	566
支 払 利 息	112		172		60
雜 損 失	1,294		1,800		506
税 引 前 損 益	△286	△0.2	△16,720	△14.1	△16,434
法 人 税 等	357	0.2	904	0.7	547
持分法による投資損益	119	0.0	35	0.0	△84
非支配持分帰属損益控除前 四半期（当期）純損益	△524	△0.4	△17,589	△14.8	△17,065
非支配持分帰属損益（控除）	66	0.0	△189	△0.1	△255
四 半 期（当期）純損益 (当社株主に帰属)	△590	△0.4	△17,400	△14.7	△16,810

(注) ①当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

②連結損益計算書の表示区分については、ASC810の適用により、当第2四半期連結会計期間の表示に合わせて組替え再表示しております。

(2) 四半期キャッシュ・フロー計算書（3か月）

(第2四半期連結会計期間)

(単位 百万円)

項目	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)	前年同期比 増（減）
<u>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>			
非支配持分帰属損益控除前四半期（当期）純損益	△524	△17,589	△17,065
営業活動により増加したキャッシュ（純額）への調整			
減価償却費等	17,046	13,918	△3,128
受取手形および売掛金の（増加）減少額	277	△3,533	△3,810
たな卸資産の（増加）減少額	△3,863	3,076	6,939
支払手形および買掛金の増加（減少）額	1,217	12,272	11,055
その他の	490	2,578	2,088
計	14,643	10,722	△3,921
<u>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>			
有形固定資産売却額	206	2,414	2,208
有形固定資産購入額	△11,670	△9,268	2,402
その他の	△1,036	△23	1,013
計	△12,500	△6,877	5,623
フリー・キャッシュ・フロー（I + II）	2,143	3,845	1,702
<u>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>			
社債および借入金の増加（減少）額	△222	5,743	5,965
セール・アンド・リースバック取引による入金額	—	2,016	2,016
その他の	△563	△560	3
計	△785	7,199	7,984
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△2,327	△1,025	1,302
現金および現金同等物純増加（減少）額	△969	10,019	10,988
現金および現金同等物期首残高	158,998	79,451	△79,547
現金および現金同等物期末残高	158,029	89,470	△68,559

(注)連結キャッシュ・フローの表示区分については、ASCO810の適用により、当第2四半期連結会計期間の表示に合わせて組替え再表示しております。

(3) セグメント情報（3か月）

（第2四半期連結会計期間）

①製品分野別売上高

（単位 百万円）

	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増（減）	
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)		
通信機器分野	16,277	9.7	13,438	11.3	△17.4	△2,839
コンピュータおよび周辺機器分野	30,565	18.3	16,774	14.2	△45.1	△13,791
民生用電子機器分野	31,892	19.0	22,601	19.1	△29.1	△9,291
自動車および産業機器分野	28,764	17.2	22,989	19.4	△20.1	△5,775
多目的・多用途IC	23,139	13.8	15,415	13.0	△33.4	△7,724
ディスクリート・光・マイクロ波	28,552	17.1	22,568	19.0	△21.0	△5,984
半導体計	159,189	95.1	113,785	96.0	△28.5	△45,404
その他	8,117	4.9	4,722	4.0	△41.8	△3,395
合計	167,306	100.0	118,507	100.0	△29.2	△48,799

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

（単位 百万円）

	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増（減）	
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)		
SoC プラットフォーム	64,528	38.6	41,821	35.3	△35.2	△22,707
MCU プラットフォーム	45,080	26.9	35,929	30.3	△20.3	△9,151
個別半導体	49,581	29.6	36,035	30.4	△27.3	△13,546
半導体計	159,189	95.1	113,785	96.0	△28.5	△45,404
その他	8,117	4.9	4,722	4.0	△41.8	△3,395
合計	167,306	100.0	118,507	100.0	△29.2	△48,799

(注)

SoC（システム・オン・チップ）プラットフォーム： ASIC（特定用途向け集積回路）、ASSP（特定用途向け標準品）、メモリ

MCU（マイクロコンピュータ）プラットフォーム： マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ

個別半導体： 表示ドライバ、アナログIC、ディスクリート半導体、化合物半導体

②所在地別売上高

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		
			構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	
日本	85,270	51.0	63,900	53.9	△25.1
米国	11,741	7.0	7,302	6.2	△37.8
欧州	24,708	14.8	14,981	12.6	△39.4
アジア	45,587	27.2	32,324	27.3	△29.1
合 計	167,306	100.0	118,507	100.0	△29.2

③所在地別営業損益

(単位 百万円)

	前第2四半期 連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		
			構成比 (%)	前年同期比 増(減) (百万円)	
日本	△3,128	—	△17,722	—	△14,594
米国	△632	—	135	—	767
欧州	901	—	△49	—	△950
アジア	2,364	—	2,179	—	△185
合 計	△495	—	△15,457	—	△14,962

7. 繼続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

平成22年3月期 第2四半期連結決算概要

【第2四半期連結累計期間】(平成21年4月1日から平成21年9月30日の6か月間)

	平成21年3月期 前第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	平成22年3月期 当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増(減)	
		金額	率	金額	率
売上高	億円 %	億円 %		億円	%
半導体売上高	3,336 100.0	2,205 100.0		△1,131	△33.9
営業損益	3,184	2,118		△1,065	△33.5
税引前損益	12 0.4	△364 △16.5		△376	—
四半期純損益	△0 △0.0	△375 △17.0		△375	—
(当社株主に帰属)	△19 △0.6	△381 △17.3		△362	—
1株当たり四半期純損益 (当社株主に帰属)	円	円		円	%
基本的	△15.44	△308.43		△292.99	—
希薄化後	△15.44	△308.43		△292.99	—

	億円	億円	億円	%
設備投資額	280	178	△102	△36.5
減価償却費等	330	282	△48	△14.5
研究開発費	567	484	△83	△14.7
米ドル為替レート(円)	円	円		
105	97			
ユーロ為替レート(円)	163	132		

【第2四半期連結会計期間】(平成21年7月1日から平成21年9月30日の3か月間)

	平成21年3月期 前第2四半期連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	平成22年3月期 当第2四半期連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)		前年同期比 増(減)	
		金額	率	金額	率
売上高	億円 %	億円 %		億円	%
半導体売上高	1,673 100.0	1,185 100.0		△488	△29.2
営業損益	1,592	1,138		△454	△28.5
税引前損益	△5 △0.3	△155 △13.0		△150	—
四半期純損益	△3 △0.2	△167 △14.1		△164	—
(当社株主に帰属)	△6 △0.4	△174 △14.7		△168	—
1株当たり四半期純損益 (当社株主に帰属)	円	円		円	%
基本的	△4.78	△140.89		△136.11	—
希薄化後	△4.78	△140.89		△136.11	—

	億円	億円	億円	%
設備投資額	187	52	△136	△72.4
減価償却費等	170	139	△31	△18.4
研究開発費	303	265	△38	△12.6
米ドル為替レート(円)	円	円		
108	95			
ユーロ為替レート(円)	166	135		

	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前期末比 増(減)		前第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日)
			金額	率	
総資産	億円	億円	億円	%	億円
株主資本	4,825	4,655	△171	△3.5	6,220
	1,281	885	△396	△30.9	2,248
従業員数	人	人	人	%	人
	22,476	22,207	△269	△1.2	23,249

(注) ①当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

②1株当たり四半期純損益(当社株主に帰属)はASC260に基づいて算出しております。

③株主資本の金額は、「米国会計基準」に基づいて表示しております。

④本四半期決算概要に記載された平成22年3月期第2四半期の連結財務情報につきましては、会計監査人による四半期レビューが終了しておりません。今後、後発事象等の発生または会計監査人による四半期レビューにより数値に変更が生じる場合があります。その場合は、速やかに訂正のプレスリリースをいたします。

⑤設備投資額は、有形固定資産(ソフトウェアを除く)取得額を表示しております。

〔将来予測に関する注意〕

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下NECエレクトロニクスと総称します。）の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1) NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2) 市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3) 激しい競争にさらされた市場においてNECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4) 為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因があります。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。
